



■ **Brief zum Jahreswechsel**

Liebe IMAPS-Mitglieder,
 nach im Jahre 2013 durchaus erfolgreichen internationalen IMAPS-Konferenzen in Orlando (USA) und der EMPC in Grenoble (Frankreich) war die nationale IMAPS Deutschland Konferenz – traditionell an der Hochschule in München ausgerichtet – mit 15 Ausstellern, 19 Vorträgen und über 115 Teilnehmern ein sichtbarer Erfolg für die Arbeit unseres Chapters in seinem nun 40jährigem Bestehen. Auf der am späten Nachmittag des 1. Konferenztages stattfindenden IMAPS Mitgliederversammlung – auch hier konnte mit 50 teilnehmenden Mitgliedern eine Rekordzahl vermeldet werden – wurde ich als 1. Vorsitzender ebenso wie unser Schriftführer Dr. Ruben Perrone

erneut wiedergewählt. Für das in uns gesetzte Vertrauen spreche ich an dieser Stelle allen stimmberechtigten Teilnehmern der Mitgliederversammlung noch einmal meinen persönlichen Dank aus.

Bereits im Vorfeld für die Wiederwahl wurde mir ans Herz gelegt als General Chair der nächsten EMPC 2015 aktiv zu werden. Turnusmäßig wird die EMPC 2015 wieder vom deutschen Chapter organisiert, dessen internes „Orga-Team“ die ersten Arbeiten bereits im Herbst 2012 aufgenommen hat. Unser 2. Vorsitzender Dr. Markus Detert gehört als Technical Chair ebenso wie unser Schatzmeister Ernst Eggelaar und unser langjähriger 1. Vorsitzender Prof. Jens Müller zum Orga-Team EMPC 2015.

Wie Sie ja alle wissen, ist zu unserem tiefsten Bedauern unser langjähriger 1. Vorsitzender Prof. Heinz Osterwinter in diesem Frühjahr verstorben. Wir werden nun ohne ihn die Organisation der EMPC 2015 bewältigen müssen und werden ihn bei unseren Arbeiten als IMAPS-Kollegen und Freund Heinz Osterwinter stets in Erinnerung behalten. Ihm ist es als Initiator und Chefplaner dieser Veranstaltung



Das Orga-Team der EMPC 2015

für 2015 zu verdanken, dass wir abermals ins Graf-Zeppelin-Haus nach Friedrichshafen am Bodensee gehen werden (www.empc2015.org). Ferner war Prof. Heinz Osterwinter auch der Schatzmeister unseres europäischen IMAPS-Zusammenschlusses (ELC), in dem wir als deutsches Chapter mit unseren ca. 300 Mitgliedern mit Abstand die stärkste Fraktion darstellen. Diese Position hat nun dankenswerter Weise unser deutscher Schatzmeister Ernst Eggelaar zusätzlich übernommen. Brigitte Braux-Touchat (Chapter Frankreich und Ausrichter der EMPC 2013 in Grenoble) stellt sich für die kommenden zwei Jahre bis zum ELC-Meeting auf unserer EMPC-Konferenz in 2015 in Friedrichshafen als ELC-Vorsitzende zur Verfügung.

Bzgl. der Organisation der EMPC 2015 gab es allerdings nach der Herbstkonferenz für uns eine schlechte Nachricht, da der von uns verpflichtete Kongressveranstalter Congrex Deutschland GmbH Insolvenz anmelden musste. Glücklicherweise erfolgte dies allerdings erst nach der gemeinsamen Entwicklung und Erarbeitung der Konferenzflyer und der Ausstellerbroschüre. Die Dokumente stehen auf unserer Webseite zum Download bereit und wurden bereits in Grenoble intensiv für die erste Werbekampagne verwendet. An dieser Stelle ist wohl auch unser Aufruf an alle IMAPS-Mitglieder und -Unterstützer zur aktiven Mitgestaltung der EMPC 2015, sei es als Aussteller, Sponsor, Vortragender oder Teilnehmer, bestens platziert.

Aus dem sogenannten erweiterten Vorstandkreis, der uns glücklicher- und dankenswerterweise Weise national auch weiterhin unterstützt, sind unsere langjährige 2. Vorsitzende Dr. Gisela Dittmar sowie unser ehemaliger Schatzmeister Hans-Ulrich Knipps ausgeschieden. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des ganzen IMAPS-Vorstandes noch einmal ganz herzlich für die langjährige aktive Mitarbeit bedanken. Um die Ziele der IMAPS weiter zu verfolgen, ist in 2013 bereits Dirk Schade (XYZTEC) zum erweiterten Vorstand hinzugekommen und Dr. Martin Oppermann (CASSIDIAN) wird unser Team ab 2014 weiter verstärken. Nochmals sei hier erwähnt, dass ohne das Engagement und den Einsatzwillen von diesen insgesamt über zehn Personen unser ehrenamtlicher „Betrieb“, wie beispielsweise die Organisation der jährlichen Herbstkonferenz und des Frühjahrsseminars aber auch die Beiträge für unsere PLUS-Sei-

ten, nicht zu realisieren wären. Bzgl. des Frühjahrsseminars wurde beschlossen dieses am Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik an der TU Dresden am 20.03.2013 zum Thema „Volume Integration – Stapeln, Falten, Vergraben“ durchzuführen. Momentan befinden wir uns bereits in der Planungsphase.

Weitere Veranstaltungen in 2014

Gleich zu Beginn des Jahres ist IMAPS Deutschland wieder Partner der 7. DVS/GMM-Fachtagung ‚Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2014 – von Hochstrom bis Hochintegration‘ in Fellbach am 11./12.02.2014, die von DVS und GMM organisiert wird. Danach wird gleich im März 2014 das bereits oben erwähnte IMAPS Frühjahrsseminar folgen.

Die ‚10. IMAPS/ACeS International Conference and Exhibition on Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies (CICMT 2014)‘ findet dieses Jahr in Osaka (Japan) vom 14. Bis 16.04.2014 (organisiert von IMAPS USA und ACeS) statt. Die ‚5. Electronics System Integration Technology Conference (ESTC)‘ wird vom 15. bis 18.09.2013 in Helsinki (Finnland) stattfinden (organisiert von IEEE CPMT, GMM, IMAPS).

Unsere IMAPS Deutschland Konferenz 2014 wurde bereits auf den 23. bis 24.10.2014 wieder an der Hochschule München terminiert. Am späten Nachmittag des 23.10.2014 wird dort auch unsere nächste Mitgliederveranstaltung stattfinden, zu der ich Sie bereits jetzt herzlich einlade. Dieses Mal liegt der Termin relativ spät im Oktober, da das jährliche IMAPS USA Symposium v47nd International Symposium on Microelectronics‘ bereits für den Zeitraum vom 13. bis 16.10.2014 in San Diego, California (USA) festgelegt wurde und wir mit einem früheren Termin dann mit dem Münchener Oktoberfest und der Semicon in Grenoble kollidieren würden.

In meinem und dem Namen des Vorstandes möchte ich abschließend allen IMAPS-Mitgliedern und Ihren Familien auch für das Jahr 2014 beste Gesundheit und beruflich größtmöglichen Erfolg wünschen. Bitte unterstützen Sie uns alle auch weiterhin tatkräftig bei der Vereinsarbeit sowie beim Networking und durch aktiven Erfahrungsaustausch.

Ihr Martin Schneider-Ramelow

1. Vorsitzender IMAPS Deutschland e.V.

■ Einladung

Im Fraunhofer IKTS, Dresden findet am 16. und 17. Januar 2014 die 8. Auflage des alle zwei Jahre stattfindenden Symposiums Vision Keramik statt.



In einem hochkarätigen Programm mit Vorträgen aus Industrie und Wissenschaft werden die Potenziale innovativer Keramiktechnologien für neue Lösungen vom Werkstoff bis zum System im Bereich der Struktur- und Funktionskeramik aufgezeigt. Dabei stehen neben aktuellen Entwicklungen von der Gebrauchs- bis zur technischen Keramik besonders die Zukunftsperspektiven der Keramik im Mittelpunkt.

Themenschwerpunkte liegen diesmal auf den Bereichen der Energie- und Umwelttechnologie und den smart materials, die sich dynamisch entwickeln. Zusammen mit dem Fraunhofer IZFP Dresden, das ab 1. Januar 2014 in das Fraunhofer IKTS integriert wird, soll das Center of Material Diagnostics CMD gegründet werden. Auch dieses Thema wird auf der Vision Keramik angesprochen werden. Im Jahr 2013 wurde schon das Fraunhofer Center for Energy Innovation CEI in Connecticut/USA gegründet. Hintergründe hierzu werden vom Center-Leiter Prof. P. Singh erläutert.

Last but not least möchte Prof. Dr. rer. nat. habil Alexander Michaelis das Symposium dazu nutzen, einen persönlichen Rückblick zu seinem 10-jährigen IKTS-Jubiläum zu bringen. Die Veranstaltung wird von einer Industrieausstellung begleitet.



Veranstaltungsort

Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS Winterbergstraße 28, 01277 Dresden

Registrierung

Bitte nutzen Sie zur Anmeldung das Onlineformular auf der Webseite: <http://www.ikts.fraunhofer.de/de/veranstaltung/vision2014/registrierung.html>.

■ Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Landshut	12.-13. März 2014	Landshuter Symposium MST	Cluster MST Hochschule Landshut,
Dresden	20. März 2014	Frühjahrsseminar: Volume Integration – Stapeln, Falten, Vergraben	IMAPS D
Oxford	20. März 2014	Micro Tech 2014, Design for Packaging & Future Technology Trends	IMAPS UK
Osaka	14.-16. April 2014	CICMT 2014	IMAPS, ACerS
Albuquerque	13.-15. Mai 2014	IMAPS HiTEC	IMAPS US
Helsinki	16.-18. Sept. 2014	ESTC 2014	IEEE CPMT

■ IMAPS Deutschland – Ihre Vereinigung für Aufbau- und Verbindungstechnik

IMAPS Deutschland, Teil der ‚International Microelectronics and Packaging Society‘ (IMAPS), stellt seit 1973 in Deutschland das Forum für alle dar, die sich mit Mikroelektronik und Aufbau- und Verbindungstechnik beschäftigen. Mit mehr als 300 Mitgliedern verfolgen wir im Wesentlichen drei wichtige Ziele:

- wir verbinden Wissenschaft und Praxis
- wir sorgen für den Informationsaustausch unter unseren Mitgliedern und
- wir vertreten den Standpunkt unserer Mitglieder in internationalen Gremien

■ Call for Paper

5. Electronic System Integration Technology (ESTC) Conference

16.-18. September 2014, Helsinki, Finland

Die Veranstaltungsreihe ESTC wird von IEEE-CPMT in Zusammenarbeit mit IMAPS Europa organisiert. Das Event im September in Helsinki schließt sich an

die erfolgreichen Veranstaltungen seit der ersten Konferenz 2006 in Dresden an. Später fanden ESTC in Greenwich, Berlin und Amsterdam statt. Teilnehmer, Referenten und Aussteller kamen zuletzt aus 26 Ländern, womit man die Konferenzreihe wahrhaft international nennen kann.



Wir möchten Sie einladen, sich Details zur Konferenz und zum call for paper auf der Website <http://www.estc2014.eu/home/estc-2014/call-for-papers> anzusehen und sich den Termin bereits weit im Voraus freizuhalten, sei es für eine Teilnahme oder den Besuch als Referent oder Aussteller.

Die Proceedings

Die der letzten Herbsttagung, die im Oktober 2013 in München stattgefunden hat, können auf CD zum Preis von 55,- € erworben werden.



Die aktuelle CD-ROM enthält neben den 2013'er Proceedings auch die mehrerer früherer Herbst- und Frühjahrsveranstaltungen. Unsere Seminare sind traditionell themenorientiert und beschäftigen sich zuletzt mit zu Themen wie ‚Medizintechnik – Herausforderungen an das Packaging‘, ‚Manche mögen's heiß – Power Electronic Packaging‘, ‚3D – mehr als nur die 3.Dimension?‘ oder ‚Ist Zuverlässigkeit noch bezahlbar?‘.

Ihre Bestellungen richten Sie bitte an:

Ernst Eggelaar, c/o Microtronic GmbH, Kleingrötzing, D-84494 Neumarkt-St.Veit, Fax +49-8722-9620-30, ee@microtronic.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß §4 Nr.22 UStG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

■ Impressum

IMAPS Deutschland e.V.

1. Vorsitzender:

Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow

martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de

Schatzmeister

(bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag):

Ernst J. M. Eggelaar,

ee@microtronic.de



Ausführliche Kontaktinformationen zu den Vorstandsmitgliedern findet man unter www.imaps.de (Vorstand)